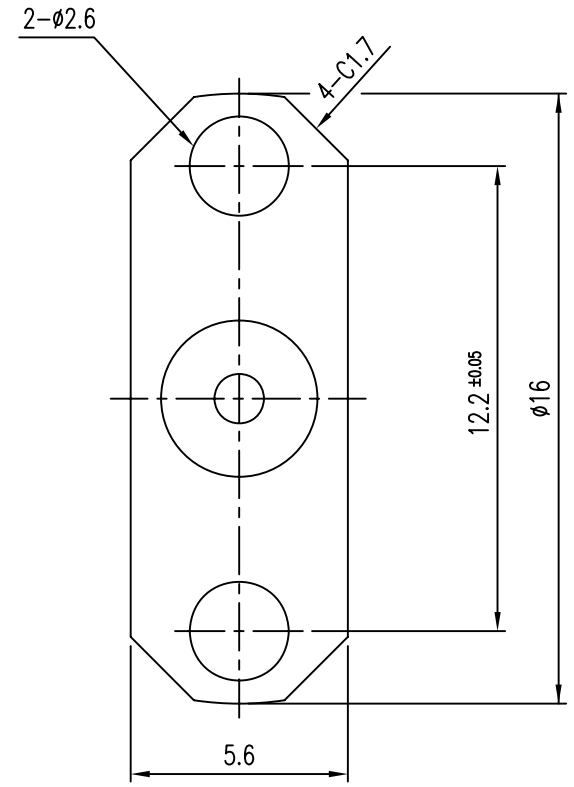
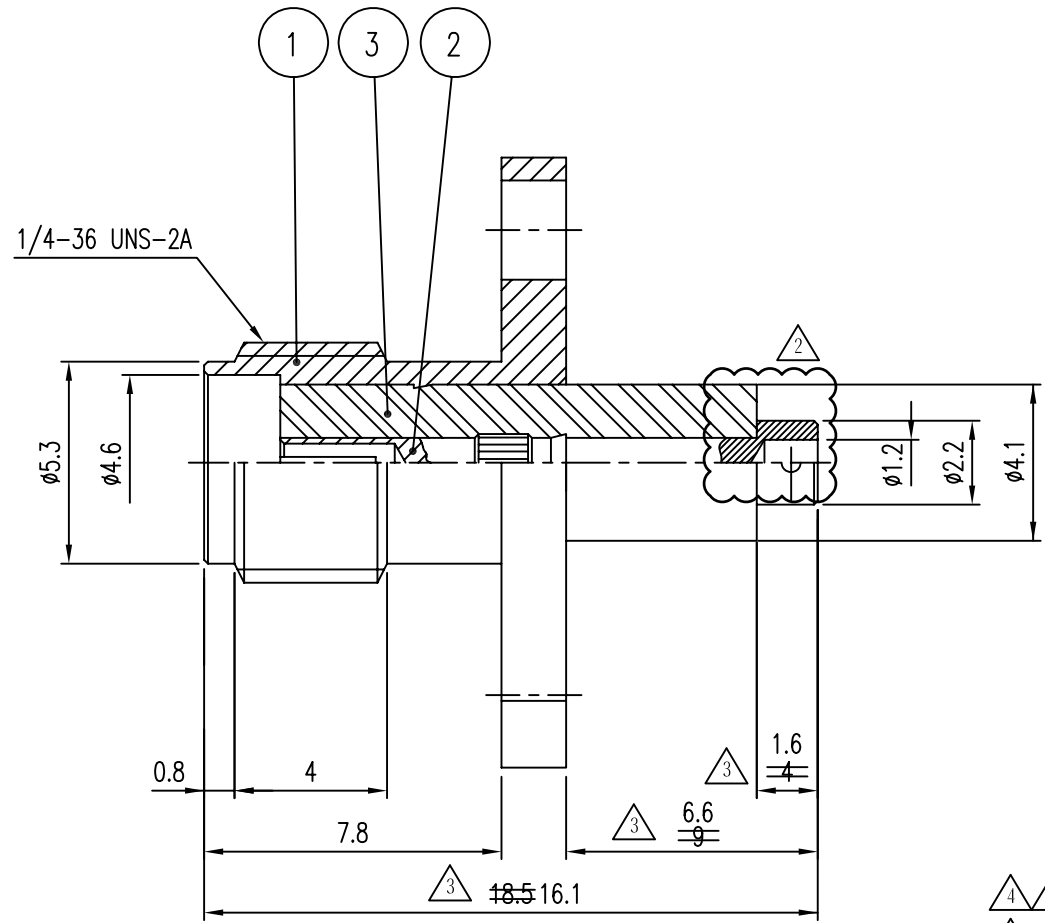


수 정 내 용									
부호	내 용	수정자	승인자	년	월	일			
1	[실변No.연구2007-153] 기타 (조립시 헐기용으로 인한 INSULATOR 외경 치수 변경)	김인철	윤상진	2007.	10.	5.			
2	[실변No.연구2007-154] 기타 (PIN 내경 HOLE 추가)	김인철	윤상진	2007.	10.	8.			
3	[실변No.연구2007-157] 기타 (특성 개선 PIN 길이 변경)	김인철	윤상진	2007.	10.	17.			
4	절연체 공용화로 인한 코드 변경	은선영	김인철	2020.	12.	24.			



3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02077-N/1 DIN00156-N/1 (H2289)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01149-5/1 (E2583)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00347-5/2 (D2182)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .* ** ±0.05	년월일	2007. 9. 27.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
	승인					
재질 _____	검도			도명	SMA-J-H2-R VER.4	
	제도					
열처리 _____	작성부서		연 구 소	A4	도번	CN00838-7/1 K314-483-200
보호파막처리 _____	적도 5/1	단위 mm				